

# 2021年12月期 決算短信(日本基準)(連結)

2022年2月15日

上場会社名 ウィンテスト株式会社

上場取引所 東

コード番号 6721 URL <https://www.wintest.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 姜 輝

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 樋口 真康

TEL 045-317-7888

定時株主総会開催予定日 2022年3月29日

有価証券報告書提出予定日 2022年3月30日

配当支払開始予定日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 2021年12月期の連結業績(2021年1月1日～2021年12月31日)

### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年12月期	307		730		668		629	
2020年12月期	805		37		50		31	

(注) 包括利益 2021年12月期 546百万円 ( %) 2020年12月期 59百万円 ( %)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2021年12月期	19.04		33.9	31.1	237.6
2020年12月期	0.96		1.5	2.1	4.6

(参考) 持分法投資損益 2021年12月期 百万円 2020年12月期 百万円

1. 当社は、2020年12月期より決算期を毎年7月31日から毎年12月31日に変更しており、決算期変更の経過期間となる2020年12月期は5ヶ月間の変則決算となっております。このため、対前期増減率は記載しておりません。また、2020年12月期の1株当たり当期純利益、総資産経常利益率及び売上高営業利益率については、5ヶ月間の利益に対する数値を記載しております。

2. 2020年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。

3. 2021年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年12月期	1,896	1,590	83.4	47.86
2020年12月期	2,411	2,132	88.3	64.40

(参考) 自己資本 2021年12月期 1,581百万円 2020年12月期 2,127百万円

### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2021年12月期	856	21	68	219
2020年12月期	384	29	3	925

## 2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
2020年12月期				0.00	0.00			
2021年12月期		0.00		0.00	0.00			
2022年12月期(予想)		0.00		0.00	0.00			

3. 2022年12月期の連結業績予想(2022年1月1日～2022年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり当期 純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)									
通期	2,000	550.2	205		204		204		6.20

\* 第2四半期(累計)の連結業績予測につきましては、開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。

注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有  
新規 社 (社名) 、 除外 1 社 (社名) オランジュ株式会社

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
以外の会計方針の変更 : 無  
会計上の見積りの変更 : 無  
修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2021年12月期	33,041,000 株	2020年12月期	33,041,000 株
期末自己株式数	2021年12月期	株	2020年12月期	株
期中平均株式数	2021年12月期	33,041,000 株	2020年12月期	33,041,000 株

(参考)個別業績の概要

1. 2021年12月期の個別業績(2021年1月1日～2021年12月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年12月期	254		589		544		509	
2020年12月期	729		106		102		80	

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2021年12月期	15.41	
2020年12月期	2.42	

1. 当社は、2020年12月期より決算期(事業年度の末日)を7月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、2020年12月期は決算期の変更により2020年8月1日から2020年12月31日までの5ヶ月決算となっているため、対前期増減率につきましては記載しておりません。また、2020年12月期の1株当たり当期純利益については、5ヶ月間の利益に対する数値を記載しております。

2. 2020年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。

3. 2021年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年12月期	1,973	1,786	90.0	53.79
2020年12月期	2,458	2,290	93.0	69.20

(参考) 自己資本 2021年12月期 1,777百万円 2020年12月期 2,286百万円

2. 2022年12月期の個別業績予想(2022年 1月 1日 ~ 2022年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	
第2四半期(累計)							
通期	1,500	489.9	19		19		円 銭 0.58

\* 第2四半期(累計)の個別業績予測につきましては、開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。

決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。また上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料5ページ「1. 経営成績等の概況(4) 今後の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況 .....	2
(1) 当期の経営成績の概況 .....	2
(2) 当期の財政状態の概況 .....	3
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況 .....	3
(4) 今後の見通し .....	5
(5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 .....	6
(6) 継続企業の前提に関する重要事象等 .....	6
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 .....	9
3. 連結財務諸表及び主な注記 .....	10
(1) 連結貸借対照表 .....	10
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 .....	12
連結損益計算書 .....	12
連結包括利益計算書 .....	13
(3) 連結株主資本等変動計算書 .....	14
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 .....	16
(5) 連結財務諸表に関する注記事項 .....	17
(継続企業の前提に関する注記) .....	17
(連結損益計算書関係) .....	17
(セグメント情報等) .....	18
(1株当たり情報) .....	22
(重要な後発事象) .....	23

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当期の経営成績の概況

当社グループでは、事業セグメントを「半導体検査装置」と「新エネルギー」に分けて事業活動を行ってまいりましたが、2022年度の新方針として、半導体検査装置事業に専念することを決定いたしました。2021年10月21日付けで、太陽光発電所のO&M（メンテナンス）を主業とする当社100%子会社であるオランジュ株式会社の全株式の譲渡を行いました。譲渡詳細に関しましては、2021年10月21日開示の「連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別利益計上に関するお知らせ」をご覧ください。

当連結会計年度における世界経済は、全世界的に当初の想定を超えて猛威を奮う新型コロナウイルス禍の影響から深刻な半導体不足が発生、当社の顧客においても半導体不足の影響や、サプライチェーン不調に伴う供給制約、資源高、需給ミスマッチによる労働力の不足を伴い、半導体市場においては、上流である半導体デバイスの開発メーカー（以下、「デザインハウス」という。）からの新デバイスのリリースなどにも影響が出たことで、半導体受託組立検査専門会社（以下、「OSAT」という。）では物流の停滞や半導体材料の不足などを原因とし、工場稼働率の低下が叫ばれる事態となりました。そのような状況は、経済市場全方位に影響を与え、例えば大手の車メーカーや電気製品メーカーであっても半導体不足、物流チェーンの乱れなどから大幅な納期遅延が発生しています。

当社への影響としましては、上述の状況から最もビジネスが活発になる下半期に、設備投資のタイミング調整が入ることとなり受注済み製品の納入タイミング調整と、下半期に強い引合いが期待された顧客からの発注に影響が出ることとなり、受注、売上は低調に推移しました。また装置の製造面では、検査装置の製造に欠かせない半導体部材の入手も困難な状態になりつつあったため、2021年上半期に通常より多くの部材の発注を行い、2021年末から2022年の製造に必要な部材の早期調達を行いました。しかし、半導体不足は現在更に深刻な状況となり当社が必要とする製造部材の納期は12カ月から高集積度半導体チップなどは18カ月と大幅な長納期となり、価格は数倍、ものによっては10倍にまで高騰しています。当社は、このような状態に対応するため、2022年においては、必要十分な部材を先行手配し、工場を止めることの無いよう計画的に部材の調達を進めてまいります。

当社グループが属する半導体並びにフラットパネルディスプレイ業界の2021年度及び同市場の長期的展望としては、2021年に想定以上の半導体不足が叫ばれ、製品需要に対し、需給バランスが崩れましたが、今後2022年は、半導体を消費するスマートフォンが安定的に伸びてまいります。その中でも特に5G仕様のハイエンド品が大きな伸びが顕著となっていくと予想されています。パソコン、タブレットなどは世界的なテレワーク等需要の高まりはあるものの半導体及び周辺部材なども、ひっ迫していることから特に2021年下半期は出荷台数が伸び悩み、その状況は今でも余波が続いています。WSTSの11月発表によると、2021年の世界半導体市場成長率は、25.6%増でしたが、2022年も引き続き11.1%増が見込まれ、半導体全体で2022年は8.8%増となり、2年連続で最高記録を更新する見込みと予想されています。（JEITAが発表する、世界半導体市場統計（WSTS）参照）

「表示デバイス市場」は、PC・タブレット・モニターに使われるITパネルの品薄はまだ続いており、動きも旺盛であります。巣ごもり需要増大からひっ迫感が出ていたTV用大型パネルは、やや落ち着きを取り戻し価格も安定したことから、2022～2023年度は、比較的新規での大型投資案件は少ないものの、ITパネルをG8.6クラスの大型基板で量産する動きや、新しいパネル製造技術の採用を考慮し、総じて安定した成長が見込まれています。（SEAJ参照）（SEAJとは、一般社団法人日本半導体製造装置協会の略称）

製造装置市場（日本）としては、2022年度は5.8%増の3兆5,500億円の成長が見込まれ、2023年度は4.2%増の3兆7,000億円と、安定的な成長が予測されています。またLCDドライバー検査装置市場では、OSATの増加などから「中国市場向け」が昨年に続き続伸、世界半導体製造量で見ると2022年中にも中国が世界市場において55%を超えるとも予想されています。（IC Insightsから引用）このような状況から、2022年に向かい当社がメインマーケットと位置づける中国市場の拡大が更に進むものと考えております。

当社の検査装置の対象のひとつであるイメージセンサーの分野は、情報端末の市場拡大もさることながら、スマートフォンの画質を一眼レフに近づける技術開発がすすんでおり、カメラの複眼化が進み、ハイエンド製品では3眼が標準になっていますが、搭載個数がスマートフォンの商品力に直結するため、さらなる多眼化が進み、イメージセンサーの需要は大きく増加、また今後大きな市場が見込まれている高速通信規格である5G（第5世代移動通信システム）技術の普及拡大に合わせた車の自動運転など、本分野も同様に急拡大し2025年には2兆6,460億円（2019年比38.5%増）が予測されています。（株式会社富士キメラ総研：イメージング&センシング関連市場総調査より）

特に当社が力を入れる、ディスプレイドライバIC検査装置では、2020年10月に開発を完了し、2021年1月末より出荷を開始した新装置WTS-577SRの、各有力顧客でのベンチマーク（お客様工場に装置を貸出し、実際の現場で量産半導体の検査ラインに投入し、検査スピードや精度、そしてデータの相関度などを評価頂くこと）は終了し、大阪事業所並びに当社100%製造子会社（中国湖北省武漢市）での増産体制構築を完了、順次出荷を行っております。そして現在更に、高速、高精度な次世代機の開発を行っており、2023年にリリースを行う方針です。同装置はLCDドライバー検査装置、イメージセンサー検査装置、ロジックデバイス検査装置、そしてフラッシュメモリーの検査にも、内部の一部のリソース基板を差し替えるだけで対応可能な装置として開発を進めております。

2021年中に当社がメインとするLCDドライバーIC検査装置、WTS-577SRを使った積極的なベンチマークを伴う中国

市場攻略の成果として、デザインハウス及びOSAT合わせて15社を超える顧客と商談を進めております。また新型コロナウイルス禍の影響から納入タイミングの調整を頂いておりました出荷分につきましても2022年1月から順次出荷を再開しております。当社グループとしては、今後も検査実績を高めて、台湾の販売店 蔚華科技股份有限公司（以下、「スパイロックス社」という。）及び当社が中国に設立した当社の100%製造子会社、偉恩測試技術（武漢）有限公司（以下、「製造子会社」という。）に販売店機能も持たせており、更なる追加受注に向け営業活動をしてまいります。

2020年からの2年間は、2020年1月から顕在化した新型コロナウイルス禍の影響を大きく受けましたが、その間、「ファブレスからの脱却」、「半導体市場において大きな成長を遂げる中国マーケットに進出できる体制の構築」、セグメントを整理し「半導体検査事業に集中」するなど、経営体制の見直しを含む新体制移行に邁進してまいりました。今後もウインテストグループとして、横浜本社、大阪事業所における開発環境整備、人材育成及び増員に努め、組織の強化を行い、総務経理部を含む各部署における業務推進体制を革新するため、ERPやITを駆使した、より機動的かつ最新の環境で、設計、開発及び経営能力を強化するとともに、トータルコストの削減、納期の短縮と品質の向上を目指し、顧客満足度を上げることで受注増、業績の向上、企業価値の増大を図り、株主様の利益につなげてまいります。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は307百万円、営業損失は730百万円、経常損失は668百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は629百万円となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

（半導体検査装置事業）

半導体検査装置事業では、昨今の半導体不足に端を発する有力顧客であるデザインハウスの稼働率低下を受け、売上・受注時期がずれ込み低調に推移しました。

この結果、売上高は240百万円、セグメント損失は722百万円となりました。

（新エネルギー関連事業）

新エネルギー関連事業においては、新型コロナウイルス禍の影響により現地作業などに大きな影響が出ました。

この結果、売上高は59百万円、セグメント損失は4百万円となりました。

## （2）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度末における流動資産は1,870百万円となり、前連結会計年度末に比べ514百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金が706百万円減少したことによるものです。

固定資産は25百万円となり、前連結会計年度末に比べ同水準となりました。

（負債）

当連結会計年度末における流動負債は201百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円の減少となりました。これは主に未払法人税が22百万円減少したことによるものです。

固定負債は103百万円となり、前連結会計年度末に比べ56百万円の増加となりました。これは主に長期借入金が増加した59百万円増加したことによるものです。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産は1,590百万円となり、前連結会計年度末に比べ541百万円の減少となりました。これは主に当期純損失により繰越利益剰余金が629百万円減少したことによるものです。

## （3）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は219百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果減少した資金は856百万円となりました。これは主に、棚卸資産の増加額557百万円等による資金の減少があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果増加した資金は21百万円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入23百万円等による資金の増加があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果増加した資金は68百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入80百万円による資金の増加があったことによるものです。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2018年7月期	2019年7月期	2020年7月期	2020年12月期	2021年12月期
自己資本比率（%）	82.7	30.1	86.1	88.3	83.4
時価ベースの自己資本比率（%）	209.8	445.0	220.0	378.2	329.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）	—	—	—	—	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）	—	—	—	—	—

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注） 1. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

2. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

3. 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

4. 2018年7月期、2019年7月期、2020年7月期、2020年12月期及び2021年12月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

#### （4）今後の見通し

通期見通しにつき、前述サマリーでご案内のとおり第30期（2022年12月期）連結累計期間における売上高は、通期で2,000百万円、同営業利益は205百万円を予想しております。

この見通しの前提は前述のように全世界で猛威を奮う新型コロナウイルス禍の影響はいまだ衰えず、変異株オミクロンの爆発的感染力によって世界中が翻弄されております。ワクチンのブースター接種を2021年半ばから開始している米国、イギリスにおいても、その感染拡大には歯止めがかからず、効果が見えるまでに相当な時間がかかっております。大きく遅れて接種の始まった日本、抑え込み効果が出つつある中国、防疫に力を入れる台湾においても、今夏までは先行きに予断を許さない状況が続くものと予想されております。このような状況を念頭におきつつ現在の営業状況及び当社の取った早期半導体部材の調達戦略から、2022年12月期において顧客要求に十分に込められると判断し2022年12月期の出荷予想を見積もっております。ただし、アナリスト専門家の意見及び当社の営業や営業戦略に必要なエンジニア、マーケティング等、現時点において、現地での活動においては、渡航時の隔離期間が長期化、また中国国内の営業やサポートで省を超えての移動などに一定の制限を受けることから、上期は見通しが難しいとの判断により、中間での予想を公表することを控えさせていただきます。なお、明確になり次第、速やかに公表を致します。

なお、連結業績予想の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。また、状況に変化がありました場合には速やかにお知らせ致します。

上述の環境下を踏まえつつ業績を伸ばす当社の取組みについてご案内します。

当社グループの主要事業である半導体検査装置事業では、高度化、多様化するお客様の検査ニーズにお応えするため、既存検査技術の革新を進め、2020年10月に高速半導体向けとして、WTS-577SRの開発を完了し、2021年1月末より出荷を開始しました。更に、現在次世代検査装置の開発を継続しており、マルチプラットフォーム設計思想とすることで、検査対象の半導体の種類拡充が可能となり、今後持続的な成長が予想されている半導体市場に追随し、当社グループの事業の成長継続と、半導体サイクルにおける市場の急速な変化に対応してまいります。さらに足元の政策として、製造能力の強化、品質管理体制の整備推進を通し、お客様にとってより信頼される企業として成長するために、以下の課題への取り組みを進めてまいります。

当社の主たる事業分野である半導体検査装置事業分野はスマートフォンに代表されるように新製品サイクルが非常に早く、おおよそ、6カ月を目途として新製品がリリースされ、その技術レベルや機能のレベルが上がるごとに新機能を実現するための半導体が要求され開発されています。そのため、当社グループとして検査装置の開発の手を緩めることなく、市場要求に合わせた新機能などの開発が必須となります。その流れは、5G高速低遅延通信規格の普及とともに加速しており、より早い技術革新が当該検査装置にも求められております。

半導体検査装置においては高精度、低コスト、高速化に加え信頼性の向上が求められるだけでなく、更に使いやすいユーザーインターフェースと、検査用プログラミング補助機能の強化などを実現する必要があります。それぞれをこれまでにないスピードで推し進めることが、同分野において求められることから、当社グループは当期より組織と業務運営体制を変更し、よりスピーディーな経営判断ができるように改革を行っております。今後とも検査ニーズに対応する検査技術や手法の開発を継続するとともに、随時開発体制の見直しと強化を行ってまいります。

世界の半導体市場はもはや中国を抜きに語れないところまできております。当社は引き続き、中国と台湾をメインマーケットとし、現地顧客のニーズを把握し当社100%出資の中国湖北省武漢市に設立した製造子会社の能力を最大限に高め、製造から納品までのタイムラグをなくすことで、現地顧客の信頼、ニーズを先取りした経営を行ってまいります。

当社第30期となります2022年からは、製造子会社に開発部を正式に設立し、新機能や高速化を目的とした開発や改良を行わせることとし、製造品質の強化、営業部の拡充を進めてまいります。当社の台湾における販売店、スパイロックス社の上海中国本部及び蘇州オフィスと共同で新規顧客へのアプローチ、既存顧客からのリピート受注の促進を図ってまいります。

また、2022年初頭に開発の完了した次世代SSDR（次世代機向け高速データ転送機能）他、2021年から開発中であった、いくつかの新機能の開発は終了或いは最終段階に入っており、現状最新機種であるWTS-577/WTS-577SRに搭載し出荷を始めました。現在開発中の次世代検査装置は、マルチプラットフォームを強く意識した構造とし、LCDドライバーIC、フラッシュメモリー、イメージセンサーをはじめ、高速ロジックIC検査にも対応するなど多様な半導体の検査ができることとし、それらの検査を制御するソフトウェアや専用インターフェースを共通化して使えるようにすることで、お客様においても、製造ライン内における資源の汎用化を実現、現場での開発スピードのアップだけでなく、導入コスト、導入リスクを大きく下げる提案が可能となります。当社は、このような新たな発想による新たな検査ニーズに対応する検査技術や手法の開発を新組織の下、進めてまいります。

当社は、中国・台湾のマーケットに参入するため、スパイロックス社と連携、当社製造子会社の営業部及び日本のテスト技術課が三位一体になった新規顧客向け検査装置貸出評価活動（以下「ベンチマーク」という。）や販売



戦略プロジェクトを推進し、なお一層販売体制を強化し、拡大が続く中国マーケットに深耕してまいります。加えて、2022年も引き続き中国における製造工場としてのエンジニアや管理組織の人員の雇用を促進し量産に向けた製造体制の強化を推し進めつつあり、中国国内の顧客から、大きな注目と期待を寄せて頂いております。また、蘇州に拠点を有するスパイロックス社オフィスにも数名のエンジニアを常駐させ、共同でサポートやデモ、ベンチマークを行える拠点とし、受注体制の拡充とスピードアップを図り、拠点からの直接サポート、納入ができる体制を整備しております。

さらに、今後、当社グループとしての具体的な営業技術戦略として、製造子会社に開発機能を持たせることは前述いたしましたが、アフターサポートの重要な面としてアプリケーションサポート要員を強化、メーカーとして現地顧客からの信頼を獲得してまいります。製造子会社を強化することで、大阪事業所は、本来のミッションである新技術の開発、新型次世代検査装置の開発並びにそれら新型装置の製造に専念できることとなります。

当社は、業務範囲の拡充を目的に、産学連携を行っております。しかしながら2020年1月に顕在化した新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、各大学機関は2022年現在も完全に元に戻っておらず、リモート授業が続き研究室も一部が活動に制限のある状況ではありますが、2021年後半からは順次再開しつつあることから、以下にそれらの進捗につきご説明申し上げます。

検査装置向け工場FA化機器技術（「自重補償機構技術」）、当該技術については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、2021年9月の段階で、より製品に近い重量キャンセル型アームのプロトタイプが完成しており、各部動作の検証を進めております。なお、特許等の申請については、既にお知らせのとおり手続きは終了しております。また今後の進め方に付き大学側と調整中でございます。当該技術は当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター（以下「ポゴタワー」という。）の着脱（約25kg～30kg）をオペレーター一人で簡単に安全に行うための補助アーム（以下「マニピュレータ」という。）で製品化を目指し、当面の目標として、その搬送可能重量を50kg前後で製品化を行います。その後応用製品として「半導体製造工場内FA化システム」、「半導体工場内物流搬送システム」等への応用が可能と考えております。

和歌山大学と進めておりました脈波（BCG、ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、研究室が2021年4月に奈良県立大学に異動となりましたので、現在は同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを継続し、製品化を急いでおります。現在、最終製品化に向けて共同開発を進め、センサーを組込んだバイタル情報インターフェースを完成させ、いくつかの試作モデルを使いあらゆる年代におけるデータのばらつきなどを取得し検証を進めております。なお、ヘルスケア管理システムの販売に関しましては、TAOS研究所に一任する方向です。

#### （5）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社グループは、「株主に対する利益還元」を経営課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主利益向上に努めるとともに、配当につきましても、業績に応じ安定的な配当の継続を行うことを基本方針としております。しかしながら、企業体質の強化や競争力の維持及び今後の事業展開に備えた安定的な資金確保が必要とされております。そのため、内部留保に重点を置いた方針を実施することもあります。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に技術やコスト競争力を高め、市場ニーズに応える製品の開発体制を強化し、また、営業分野における海外での活動を展開するための原資として備えたいと考えております。

なお、当社グループは期末配当に加え、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に規定し、年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当連結会計年度の配当につきましては、業績並びに厳しい経営環境を鑑み、誠に遺憾ながら引き続き無配とさせていただきます。

#### （6）継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度においては決算期末を12月末に変更したことにより5か月間となりましたが、15期ぶりに黒字転換を果たし、営業利益37百万円を計上、親会社株主に帰属する当期純利益31百万円を計上しております。なお、営業キャッシュ・フローは、売上債権の増加等により384百万円のマイナスとなりました。また、当連結会計年度において、当社グループの半導体検査装置事業については、中国・台湾において新型コロナウイルス禍中ではあるものの、特に前期発表した新LCDドライバーIC検査装置WTS-577SRの引き合いも多く、複数顧客からの要請により、導入を前提とした評価目的としての装置の貸出を伴う積極的なベンチマークを行っております。しかしながら、昨今の半導体不足に端を発する有力顧客であるデザインハウスの新デバイスのリリース遅延から、OSATのライン稼働率の急激な低下を受け、引合いのあった売上・受注時期がずれ込み、業況は低調に推移した結果、当連結会計年度における売上高は240百万円となりました。また新エネルギー関連事業についても、太陽光システムの保守点検・整備・保証管理領域に注力してはいたしましたが、まん延防止等重点措置並びに緊急事態宣言下の制約もあり、出張を伴う野外作業が主となることから、作業の延期・中止等の要請により業績は伸び悩み、売上高

は59百万円となりました。

よって、当社グループの連結ベース売上高は307百万円となり、半導体検査装置事業の利益率が低調であったこと及び労務費、一般管理費も増加したことから、営業損失730百万円となり、親会社株主に帰属する当期純損失を629百万円計上しております。なお、営業キャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失及び受注に対応する棚卸資産の増加等により856百万円のマイナスとなっております。

以上のとおり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を解消するため、以下の取組みを継続して実施しております。

まず、半導体検査装置事業では、2022年以降半導体製造企業の新規投資は、通信の5G化（移動高速データ通信低遅延技術）が普及するにあわせ、LiDARに代表される技術である自動運転や、ミスが許されない遠隔手術やロボット制御、身の回りのあらゆる「物」がインターネットに繋がる、IoTの大きな変革が起きようとしています。これは半導体集積回路（以下ICという。）の機能面にも大きな変化があることが予想されており、いわゆる5G投資が注目されています。当社でもその技術変化に応じたタイムリーな検査技術の開発が必須となります。特に当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバーIC検査装置は、PC・タブレット、そしてスマートフォン等に多く使用されている各種半導体、とりわけLCDドライバーIC（画面に絵を表示するIC）の検査に使用されており、また、それら情報端末ではLCDドライバーICだけではなく、当社が得意とするCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど周辺半導体デバイスの需要も同時に大きく伸びてまいります。当社が2020年10月に発表し、2021年から出荷を開始したWTS-577SRにつきましては、顧客からのベンチマーク要請に積極的に応え、ベンチマーク結果に一定の評価を頂くことができました。2022年度に入り、旧正月明けから徐々にデザインハウス及びOSATの事業活動は、活発化してまいりましたので、2021年度中に出荷を見合わせておりました受注済の検査装置を、2022年1月から順次出荷を開始、2022年中に売上計上を行う予定であります。今後さらにスパイロックス社、製造子会社と協働での顧客攻略を進めるとともに、アフターサポート体制の拡充と強化を進め、中国における販売チャンネルを活かし、新規、既存顧客等複数企業からの受注活動を強化してまいります。製造子会社においては、コストの削減と顧客対応力の両方を強化を行ってまいります。他方、製造品質の向上にも注力するため、日本からのキーエンジニアの常駐政策も並行して行い、基盤の強化を行います。

今後、既存装置に係る工場機能は主に製造子会社に移し、大阪事業所は、新型次世代検査装置の開発設計と製造に注力してまいります。さらに大きく当社の事業を伸ばすため、当社の製造子会社の製造ライン横に設営しているクラス100（1㎡の空間に埃が100個以下）のクリーンルームを生かし、お客様のIC（アルミウエーハ）を借用したインターナルベンチマークを行うことで、お客様の工場で発生した新たな問題に対し早期解決を図ること、また問題解決にあたり必要以上にお客様の製造ラインを止める必要がなくなります。その結果、顧客信頼度を高めることができます。これは特に製造子会社が受け持つ有力な大型OSAT向けに直接営業を行う上で大変重要な戦略となります。このような戦略を積極的に進めることが、受注・売上の増大を図り、2022年度（当社第30期）の予算を達成する礎となります。

さらに、次世代マルチプラットフォーム検査装置で開発予定の高速ロジックテスターについては、より広範囲のロジックIC検査に対応させる計画で有り、2022年度内の完成を見込んでおります。本装置については既に複数のお客様からも問い合わせを受けており、計画どおりの開発完成を目指してまいります。

また、上述しましたとおり、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術、データ解析技術を生かし、現在開発中のマルチプラットフォーム検査装置によって、今後の市場拡大が見込まれるメモリーIC、イメージセンサーIC等への検査分野拡大に加え、5G通信規格の台頭とともに新たに注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を、3年後をめどにM&Aなども視野にシナジーの高い事業会社との資本・業務提携、並びに産学連携を積極的に進め、当該分野へ新規参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を計画、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

自重補償機構技術プロジェクトは、昨年新型コロナウイルス禍における大学研究室の閉鎖など進捗に大きな支障が出ましたが、昨年後半からは研究室の再開もあり、より製品に近い試作モデルも完成し、当社の検査装置に付属させるコンピュータの完成イメージに近づいており2022年度中には当社装置に搭載できるものと考えております。詳細は上述しておりますので、そちらをご参照ください。

当社が、奈良県立大学並びにTAOS研究所と進めております脈波（ECG, BCGセンサーを利用したバイタルデータ）を利用したヘルスケア管理システムも同様に、製品化に大きく近づいており、また、バイタルインターフェースの試作モデルが完成しましたので、より多くのデータを取得し、その精度を高める作業に着手しており、当期中の製品化を計画しています。なお、販売はTAOS研究所が自身の既存の販売チャンネルを使って販売をする計画であります。海外からのお問い合わせがあった場合は当社が輸出販売を行います。

経費水準については、大阪事業所並びに中国製造子会社の開設に伴う運転資金及び研究開発費等により増加しておりますが、国内における製品の製造委託コストに変化はないものの、部材調達につきましては、半導体不足の影響を色濃く受けており、その納期の長期化やコストの上昇が深刻ではありますが、経営判断により2021年の早期に

思い切った部材調達を行いました。しかし、その甲斐あって、今年度は半導体不足に影響されることなく、装置の納期、サポートともにスピーディに行うことができます。現地での製品やサポートの品質向上にも同時に取り組み、売上予算の達成に向けて邁進いたします。

財務面については、折からの半導体不足が深刻さを増し、当社の検査装置に不可欠な半導体部品の大幅な納期遅延、大幅な価格高騰を受け、タイムリーな装置製造に支障がでる恐れがあるとのことから経営判断により、2021年前半に必要な早期の部材仕入れを行った結果、運転資金となる現預金が減少しております。財務基盤の安定化を求め、2021年11月に金融機関からの新規借入を行い、更に2022年1月31日に開催の取締役会において、資本増強につながる割当予定先への第三者割当による新株予約権の発行を決議いたしました。これにより、今後の事業継続に必要な開発及び運転資金を確保するとともに、2022年後半から2023年の製造に必須となる製造部材の調達に必要な資金の確保及び財務基盤の強化を図りました。今後早急に、親会社である武漢精測電子集団股份有限公司と諮りながら、親会社及び金融機関からの借入等による更なる資金確保のための施策も実施してまいります。

以上のとおり、台湾、中国を中心とするビジネス機会や売上・受注の増加が見込まれること、受注済みの検査装置の売上・入金が見込まれること及び上述の資金調達の実施により、今後の運転資金に必要な十分な現預金を確保していることから、継続企業的前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

## 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

## 3. 連結財務諸表及び主な注記

## (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	925,783	219,109
受取手形及び売掛金	507,307	36,517
商品及び製品	78,919	159,086
仕掛品	466,410	813,968
原材料及び貯蔵品	314,753	510,474
前渡金	13,457	11,421
未収消費税等	21,849	45,418
その他	56,918	74,785
流動資産合計	2,385,400	1,870,782
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	△8,182	△8,182
建物（純額）	—	—
車両運搬具	8,885	8,885
減価償却累計額	△8,885	△8,885
車両運搬具（純額）	—	—
工具、器具及び備品	183,739	181,952
減価償却累計額	△183,739	△181,952
工具、器具及び備品（純額）	—	—
リース資産	4,391	—
減価償却累計額	△4,391	—
リース資産（純額）	—	—
有形固定資産合計	—	—
無形固定資産		
ソフトウェア	1,439	—
無形固定資産合計	1,439	—
投資その他の資産		
その他	27,750	28,313
貸倒引当金	△3,384	△2,884
投資その他の資産合計	24,366	25,429
固定資産合計	25,806	25,429
資産合計	2,411,206	1,896,211

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	88,911	82,766
未払金	40,211	49,821
1年内返済予定の長期借入金	7,176	13,020
未払法人税等	23,685	848
製品保証引当金	4,462	1,907
前受金	10,595	4,810
その他	56,155	48,699
流動負債合計	231,198	201,873
固定負債		
長期借入金	37,020	96,964
リース債務	4,112	514
資産除去債務	6,233	6,325
その他	516	106
固定負債合計	47,882	103,910
負債合計	279,080	305,783
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,954,325	1,000,000
資本剰余金	3,061,574	1,286,486
利益剰余金	△3,875,924	△775,689
株主資本合計	2,139,975	1,510,797
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△12,030	70,434
その他の包括利益累計額合計	△12,030	70,434
新株予約権	4,180	9,196
純資産合計	2,132,125	1,590,428
負債純資産合計	2,411,206	1,896,211

（2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
（連結損益計算書）

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 2020年8月1日 至 2020年12月31日）	当連結会計年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
売上高	805,047	307,576
売上原価	409,419	289,515
売上総利益	395,628	18,061
販売費及び一般管理費	358,539	748,771
営業利益又は営業損失（△）	37,089	△730,710
営業外収益		
受取利息	749	558
為替差益	—	56,570
補助金収入	16,164	4,722
その他	873	1,306
営業外収益合計	17,788	63,156
営業外費用		
支払利息	469	766
為替差損	3,740	—
その他	0	497
営業外費用合計	4,210	1,264
経常利益又は経常損失（△）	50,667	△668,818
特別利益		
関係会社株式売却益	—	41,454
固定資産売却益	439	—
特別利益合計	439	41,454
特別損失		
減損損失	11,530	3,392
特別損失合計	11,530	3,392
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	39,575	△630,756
法人税、住民税及び事業税	7,872	2,620
法人税等還付税額	—	△4,198
法人税等調整額	—	—
法人税等合計	7,872	△1,577
当期純利益又は当期純損失（△）	31,703	△629,178
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）	31,703	△629,178

（連結包括利益計算書）

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 2020年8月1日 至 2020年12月31日）	当連結会計年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）	31,703	△629,178
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	27,573	82,464
その他の包括利益合計	27,573	82,464
包括利益	59,276	△546,713
（内訳）		
親会社株主に係る包括利益	59,276	△546,713
非支配株主に係る包括利益	—	—



（3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 2020年8月1日 至 2020年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	2,954,325	3,061,574	△3,907,627	2,108,272
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純利益			31,703	31,703
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	31,703	31,703
当期末残高	2,954,325	3,061,574	△3,875,924	2,139,975

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額 合計		
当期首残高	△39,603	△39,603	2,090	2,070,758
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純利益				31,703
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	27,573	27,573	2,090	29,663
当期変動額合計	27,573	27,573	2,090	61,366
当期末残高	△12,030	△12,030	4,180	2,132,125

当連結会計年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	2,954,325	3,061,574	△3,875,924	2,139,975
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純損失（△）			△629,178	△629,178
減資	△1,954,325	1,954,325		—
欠損填補		△3,729,413	3,729,413	—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	△1,954,325	△1,775,087	3,100,235	△629,178
当期末残高	1,000,000	1,286,486	△775,689	1,510,797

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△12,030	△12,030	4,180	2,132,125
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純損失（△）				△629,178
減資				—
欠損填補				—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	82,464	82,464	5,016	87,480
当期変動額合計	82,464	82,464	5,016	△541,697
当期末残高	70,434	70,434	9,196	1,590,428

（4）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 2020年8月1日 至 2020年12月31日）	当連結会計年度 （自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	39,575	△630,756
減価償却費	50	267
減損損失	11,530	3,392
関係会社株式売却損益（△は益）	—	△41,454
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,696	—
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,207	△2,555
受取利息及び受取配当金	△749	△558
支払利息	469	766
為替差損益（△は益）	0	△26,664
売上債権の増減額（△は増加）	△399,184	464,194
棚卸資産の増減額（△は増加）	△34,425	△557,946
前渡金の増減額（△は増加）	2,543	55
仕入債務の増減額（△は減少）	△29,624	△22,240
未払又は未収消費税等の増減額	58,250	△24,326
その他	△25,986	△893
<b>小計</b>	<b>△381,039</b>	<b>△838,719</b>
利息及び配当金の受取額	749	558
利息の支払額	△416	△766
法人税等の支払額	△3,550	△17,157
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△384,256</b>	<b>△856,085</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	23,992
有形固定資産の取得による支出	△20,689	△220
無形固定資産の取得による支出	△4,515	△2,000
その他	△3,940	80
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△29,144</b>	<b>21,852</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入れによる収入	—	80,000
長期借入金の返済による支出	△2,392	△6,814
リース債務の返済による支出	△1,303	△2,576
その他	—	△1,992
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△3,695</b>	<b>68,617</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	22,161	58,941
<b>現金及び現金同等物の増減額（△は減少）</b>	<b>△394,935</b>	<b>△706,674</b>
現金及び現金同等物の期首残高	1,320,719	925,783
現金及び現金同等物の期末残高	925,783	219,109

（5）連結財務諸表に関する注記事項  
（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結損益計算書関係）

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
役員報酬	25,470千円	62,338千円
給料及び手当	107,741	175,234
研究開発費	102,046	266,215

※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

	前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
	102,046千円	266,215千円

※3 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。

	前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
	4,524千円	7,862千円

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

## 1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

したがって、当社グループは「半導体検査装置事業」及び「新エネルギー関連事業」の2つを報告セグメントとしております。

「半導体検査装置事業」は、イメージセンサー、ディスプレイ及びディスプレイのドライバICの製造工程の各検査工程に使用される検査装置の開発、設計、販売、貸与並びに技術サポートを展開しています。

「新エネルギー関連事業」は太陽光発電システムの保守点検・整備・保証管理に関する事業等を展開しています。

## 2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

## 3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2020年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			その他	調整額 (注) 1	連結財務諸 表計上額 (注) 2
	半導体検査 装置事業	新エネルギー 関連事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	719,323	83,011	802,335	2,711	—	805,047
セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	719,323	83,011	802,335	2,711	—	805,047
セグメント利益又はセグメ ント損失 (△)	44,556	△3,634	40,921	△4,287	455	37,089
その他の項目						
減価償却費	50	—	50	—	—	50
のれん償却額	—	—	—	—	—	—

(注) 1. セグメント利益又はセグメント損失 (△) の調整額455千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

2. セグメント利益又はセグメント損失 (△) は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っているオーディオ事業を含んでおります。

4. セグメント資産の金額については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。ただし、配分されていない資産の減価償却費等は、合理的な配賦基準で各事業セグメントへ配賦しております。

当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位: 千円)

	報告セグメント			その他	調整額 (注) 1	連結財務諸 表計上額 (注) 2
	半導体検査 装置事業	新エネルギー 関連事業	計			
売上高						
外部顧客への売上高	240,250	59,394	299,644	7,931	—	307,576
セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	240,250	59,394	299,644	7,931	—	307,576
セグメント損失 (△)	△722,773	△4,327	△727,101	△4,428	819	△730,710
その他の項目						
減価償却費	267	—	267	—	—	267
のれん償却額	—	—	—	—	—	—

(注) 1. セグメント損失 (△) の調整額819千円は、セグメント間取引消去によるものであります。

2. セグメント損失 (△) は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、当社が行っているオーディオ事業を含んでおります。

4. セグメント資産の金額については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。ただし、配分されていない資産の減価償却費等は、合理的な配賦基準で各事業セグメントへ配賦しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2020年8月1日 至 2020年12月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	中国	台湾	インドネシア	合計
127,862	100,144	573,651	3,389	805,047

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
Spirox Corporation	570,711	半導体検査装置事業
Jilin Province New Century Optic-Electric Co., Ltd.	100,144	半導体検査装置事業

当連結会計年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	中国	台湾	インドネシア	合計
233,967	2,665	21,682	49,261	307,576

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
PT. EPSON BATAM	49,261	半導体検査装置事業
日本放送協会	48,650	半導体検査装置事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2020年8月1日 至 2020年12月31日）

金額的重要性が乏しいため省略します。

当連結会計年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

金額的重要性が乏しいため省略します。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2020年8月1日 至 2020年12月31日）

（単位：千円）

	半導体検査装置 事業	新エネルギー 関連事業	計	その他	全社・消去	連結財務諸表 計上額
当期末残高	—	—	—	—	—	—

（注）のれんの償却額については、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

（単位：千円）

	半導体検査装置 事業	新エネルギー 関連事業	計	その他	全社・消去	連結財務諸表 計上額
当期末残高	—	—	—	—	—	—

（注）のれんの償却額については、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2020年8月1日 至 2020年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）

該当事項はありません。



（1株当たり情報）

	前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1株当たり純資産額	64円40銭	47円86銭
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額（△）	0円96銭	△19円04銭

（注）1. 2020年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。また、2021年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
純資産の部の合計額（千円）	2,132,125	1,590,428
純資産の部の合計額から控除する金額（千円）	4,180	9,196
（うち新株予約権（千円））	4,180	9,196
普通株式に係る期末の純資産額（千円）	2,127,945	1,581,232
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株）	33,041,000	33,041,000

3. 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2020年12月31日)	当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額（△）		
親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額（△）（千円）	31,703	△629,178
普通株主に帰属しない金額（千円）	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額（△）（千円）	31,703	△629,178
普通株式の期中平均株式数（株）	33,041,000	33,041,000
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	2020年2月20日取締役会決議による第8回新株予約権 264,000個 (普通株式264,000株)	2020年2月20日取締役会決議による第8回新株予約権 250,000個 (普通株式250,000株)

（重要な後発事象）

（第三者割当による新株予約権の発行）

当社は、2022年1月31日開催の取締役会において、以下のとおり、三田証券株式会社（以下、「割当予定先」という。）を割当先とする第三者割当の方法による第9回新株予約権（行使価額修正条項付、以下「本第9回新株予約権」という。）及び第10回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付、以下、「本第10回新株予約権」といい、本第9回新株予約権と総称して「本新株予約権」という。）の発行を決議しております。

1. 本新株予約権の概要は以下のとおりであります。

(1) 割当日	2022年2月16日
(2) 発行新株予約権の総数	35,310個 本第9回新株予約権 30,310個 本第10回新株予約権 5,000個
(3) 新株予約権の払込金額	本第9回新株予約権 1個当たり115円 本第10回新株予約権 1個当たり 28円 (本新株予約権の払込総額 3,625千円)
(4) 数新株予約権の目的である株式の種類及び数	当社普通株式 3,531,000株（新株予約権1個につき100株） 本第9回新株予約権 当社普通株式 3,031,000株 本第10回新株予約権 当社普通株式 500,000株 本新株予約権の下限行使価額は132円ですが、下限行使価額においても潜在株式数は3,531,000株であります。
(5) 行使価額及び行使価額の修正	当初行使価額 本第9回新株予約権 164円 本第10回新株予約権 400円  (本第9回新株予約権) 行使価額の修正は、割当日以後、本第9回新株予約権の発行要項第17項に定める本第9回新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下、「修正日」という。）の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額（以下、「修正日価額」といいます。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正される。ただし、修正日にかかる修正後の行使価額が132円（以下、「下限行使価額」といい、本第9回新株予約権の発行要項第10項の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。 (本第10回新株予約権) ①当社は、資金調達のため必要と判断した場合、当社取締役会の決議により、本第10回新株予約権を行使価額修正型の新株予約権に転換することができ、かかる転換権の行使後は②に従い本第10回新株予約権に係る行使価額の修正を行うことができるものとする。 ②行使価額は、本第10回新株予約権の発行要項第8項の効力発生日以後、本第10回新株予約権の発行要項第17項第3号に定める本第10回新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正される。ただし、修正日にかかる修正後の行使価額が132円（以下、「下限行使価額」といい、本第10回新株予約権の発行要項第10項の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。

(6) 募集の方法	第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権を三田証券株式会社に割り当てる。
(7) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金	本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし（計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(8) 本新株予約権の行使期間	2022年2月17日から2024年2月16日まで
(9) その他	当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買受契約（以下、「本買受契約」といいます。）を締結する予定です。 本買受契約においては、割当予定先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当予定先からの譲受人が割当予定先の本買受契約上の地位及びこれに基づく権利義務を承継する旨が規定される予定です。

## 2. 資金の使途

なお、本第9回新株予約権発行による差引手取概算額497,781千円の具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。

具体的な使途	金額	支出予定時期
事業（製造）継続のための運転資金		
(i) 製造部材調達及び外注製作費 検査装置製造部材、主に半導体 検査装置外部組立費（電子基板含）	407,781千円	2022年2月～2022年9月
(ii) 技術者増強及び運転資金 電子装置の設計や開発ができるエンジニアの採用と増加 する運転資金など	90,000千円	2022年2月～2022年9月

本第10回新株予約権発行による差引手取概算額200,000千円の具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。

具体的な使途	金額	支出予定時期
(i) 既存・新規 事業領域の成長戦略		
① 既存検査装置の機能向上のための開発費用 高速通信規格への対応技術の開発等	30,000千円	2022年9月～2024年6月
② 新検査装置事業領域参入のための開発費用 次世代液晶ドライバーIC検査装置等	50,000千円	2022年9月～2024年6月
③ シナジーを考えた有力企業等との事業提携	60,000千円	2022年9月～2024年3月
(ii) 製造能力の増強		
④ 製造能力増強のための各事業所整備	60,000千円	2022年9月～2024年3月